

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，亦不構成訂立協議以進行任何該等事項的邀請，且不屬收購、購買或認購任何證券的要約邀請。

本公告並非於美國(包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區)出售證券的要約或邀請或其組成部分。本公告或其任何內容或其任何副本亦不得攜進美國境內或於美國境內直接或間接派發。除非本公告所述證券根據1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)登記或獲豁免遵守證券法或美國任何其他適用證券法律的登記規定，否則有關證券並無亦不會根據證券法或美國任何其他適用證券法律登記，且不得於美國提呈發售、出售或以其他方式轉讓。任何在美國提呈的證券公開發售必須由本公司刊發招股章程，當中須載列本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司無意在美國公開發售任何證券。



Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd.

上海天數智芯半導體股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9903)

根據一般授權配售新H股

整體協調人、聯席賬簿管理人及配售代理

Goldman Sachs 高盛

Morgan Stanley
摩根士丹利

华泰国际
HUATAI INTERNATIONAL

(按字母順序)

被動聯席賬簿管理人及配售代理

J.P.Morgan
摩根大通

董事會欣然宣佈，於2026年7月9日（聯交所交易時段前），本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理已有條件及單獨（而非共同或共同及單獨）同意作為本公司代理盡力促使合共不少於六名承配人按配售協議所載條款及在其條件規限下購買14,857,000股新H股，配售價為每股H股476.00港元。

配售股份分別佔於本公告日期已發行H股及已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的約6.06%及約5.84%，且分別佔經配發及發行配售股份擴大後的已發行H股及已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的約5.72%及約5.52%（假設除將予配發及發行配售股份外，自本公告日期至交割日期已發行股份未發生變動）。配售項下配售股份的總面值將為人民幣14,857,000元。

配售價每股H股476.00港元較：

- (i) 最後交易日於聯交所所報收市價每股H股560.00港元折讓約15.00%；及
- (ii) 緊接最後交易日（包括該日）前最後五個連續交易日於聯交所所報平均收市價每股H股590.70港元折讓約19.42%。

假設所有配售股份均獲悉數配售，配售所得款項總額及所得款項淨額（扣除佣金及估計開支後）預期分別為約7,071.9百萬港元及約7,033.5百萬港元。據此計算，每股配售股份的淨發行價將約為473.41港元。

配售股份將由本公司根據一般授權發行。

本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。

由於配售完成須待配售協議項下的若干先決條件達成後方可作實，故配售未必會進行。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

根據一般授權配售新H股

董事會欣然宣佈，於2026年7月9日(聯交所交易時段前)，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理已有條件及單獨(而非共同或共同及單獨)同意作為本公司代理盡力促使合共不少於六名承配人購買14,857,000股新H股，配售價為每股H股476.00港元。

配售協議

配售協議的主要條款載列如下：

日期

2026年7月9日(聯交所交易時段前)

訂約方

- (i) 本公司；及
- (ii) 配售代理。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，配售代理及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。

配售

根據配售協議，配售代理已有條件及單獨(而非共同或共同及單獨)同意作為本公司代理盡力促使合共不少於六名承配人購買14,857,000股新H股，配售價為每股H股476.00港元。

配售股份

根據配售協議的條款並在配售協議的條件規限下，本公司將發行14,857,000股每股面值人民幣1.00元的新H股，該等股份將計入本公司註冊股本。

配售股份分別佔於本公告日期已發行H股及已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的約6.06%及約5.84%，且分別佔經配發及發行配售股份擴大後的已發行H股及已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的約5.72%及約5.52%(假設除將予配發及發行配售股份外，自本公告日期至交割日期已發行股份未發生變動)。配售項下配售股份的總面值將為人民幣14,857,000元。

承配人

配售代理將盡力將配售股份配售予不少於六名屬獨立專業及機構投資者的承配人，而彼等及彼等的最終實益擁有人均為獨立第三方。預期於緊隨配售完成後，概無任何承配人將成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

配售價

配售價每股H股476.00港元較：

- (i) 最後交易日於聯交所所報收市價每股H股560.00港元折讓約15.00%；及
- (ii) 緊接最後交易日(包括該日)前最後五個連續交易日於聯交所所報平均收市價每股H股590.70港元折讓約19.42%。

配售價乃基於H股當前市價釐定，並由本公司與配售代理經公平磋商釐定。董事認為，配售價屬公平合理，且配售符合本公司及股東的整體利益。

配售股份的地位

配售股份於繳足股款時將在所有方面與於交割日期或之前本公司已發行或將予發行的其他H股具有同等地位，包括享有於交割日期或之後所宣派、作出或支付的所有股息及其他分派的權利。

配售的條件

配售須待以下條件達成或獲豁免(倘適用)後方告完成：

- (i) 聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣，且有關批准其後於配售股份存入香港中央結算有限公司營運的中央結算及交收系統前並無被撤銷；
- (ii) 已取得所有相關中國監管機構就配售授予配售代理合理滿意的所有必要批准及許可，且該等批准及許可與配售協議條款並無重大衝突或對其作出任何變更，亦未對配售協議任何一方施加任何重大不利條件；
- (iii) 於配售交割前，並無發生：
 - (A) 本公司或本集團整體的財務或其他狀況或盈利、資產、業務、經營或前景的任何重大不利變動或合理可能涉及重大不利變動的任何發展；或
 - (B) (a)聯交所暫停或限制本公司任何證券交易或(b)聯交所、上海證券交易所、深圳證券交易所、倫敦證券交易所、紐約證券交易所或納斯達克全國市場全面暫停或限制交易；或
 - (C) 香港、中國或美國爆發任何敵對行動或有關行動升級、恐怖主義行動，宣佈該等地區或國家進入緊急或戰爭或其他災難或危機狀態；或
 - (D) 香港、中國或美國的商業銀行或證券交收或結算服務發生任何嚴重中斷及／或香港、中國或美國有關當局宣佈全面暫停商業銀行活動；或
 - (E) 香港、中國或美國金融市場或國際金融、政治或經濟形勢、貨幣匯率、外匯管制或稅務方面出現任何重大不利變動或涉及潛在重大不利變動的發展，

則配售代理全權認為，以上事件將導致配售配售股份或執行購買配售股份的合約不切實可行或不可取，或會嚴重影響配售股份於二級市場的買賣；

- (iv) 本公司依據配售協議作出的陳述及保證，於截至配售協議日期及交割日期均屬真實、準確且並無誤導性；
- (v) 於交割日期或之前，本公司已遵守配售協議項下的所有約定與承諾，並滿足在該協議下須遵守或達成的所有條件；
- (vi) 配售代理已於交割日期收到配售代理的美國法律顧問就表明配售代理根據配售協議所載規定發售及銷售配售股份無須根據證券法進行註冊，以及配售代理合理要求的其他事項的意見，有關意見的形式及實質內容須令配售代理合理信納；及
- (vii) 配售代理已於交割日期收到(a)中國證監會備案的最終稿或基本定稿及(b)本公司中國法律顧問的意見，有關稿件的形式及實質內容須令配售代理合理信納。

除上述第(i)及第(ii)項條件外，配售代理可全權酌情豁免上述任何一項條件。

完成配售

在上述所有條件達成(或獲豁免(倘適用))的前提下，配售將於交割日期(即2026年7月13日)，或於本公司與整體協調人(為其本身及代表配售代理)書面協定且符合上市規則的其他時間及／或日期完成。

發行配售股份的一般授權

配售股份將由本公司根據一般授權發行，據此，董事會獲授權發行、配發及處理最多於年度股東會當天已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%的股份，合共50,863,547股。截至本公告日期，本公司尚未動用一般授權，而配售項下的配售股份約佔一般授權的29.21%。董事會已批准根據一般授權進行配售，且配售無需進一步取得股東批准。

禁售

根據配售協議，未經整體協調人事先書面同意，本公司不得(i)直接或間接進行、安排或促成配售、配發、發行或從庫存中轉讓，或要約配發、發行或從庫存中轉讓或授出任何認購選擇權、權利或認股權證，或訂立任何旨在或合理預期會導致上述任何情況的交易(無論是通過實際處置或因現金結算或其他原因導致的經濟處置)，包括本公司的任何股本證券或任何可轉換為、可行使或可交換為本公司股本證券的證券；(ii)訂立任何掉期或類似協議，全部或部分轉移該等股份的經濟所有權風險，無論上述(i)或(ii)項所述交易是否以股份或其他證券交付、以現金或其他方式結算；(iii)公開宣佈有意進行任何上述交易；限制期自本配售協議日期起至交割日期後90日止。上述規定不適用於(i)根據配售協議發行配售股份及(ii)根據年度股東會採納的H股股權激勵計劃授出的激勵(如有)以及在歸屬時任何相應發行及配發的H股。

配售理由及裨益及配售所得款項用途

自2026年初以來AI產業環境迅速發展變化，包括AI技術快速發展、AI應用在中國加速滲透以及AI token消耗量爆發式增長，這些因素已推動對GPGPU算力解決方案(包括本公司所供應的解決方案)的需求激增，其規模已超出本公司上市時所預期的水平，並將持續支持本公司下一階段的業務擴張。這些發展，加上供應鏈管理、產品迭代及大規模商業化所伴隨的資本密集度日益增加，導致了額外的資金需求，而這些需求在本公司上市時並未被充分考慮。

自上市以來，本公司持續推進研發、商業化、產品迭代、技術升級及生態系統發展，並已根據招股章程及其截至2025年12月31日止年度的年報所披露的用途，運用全球發售所得款項。鑒於市場格局不斷變化及商業機會日益擴大，董事會認為，主動強化本公司的資本基礎乃審慎之舉，可使本集團迅速回應新興需求，並維持長期競爭力。本公司已識別出上市後的資金需求，而這些需求在進行全球發售時並未被充分考量。具體而言，本公司擬將配售所得款項淨額用於強化供應鏈建設及戰略性採購、加速產品迭代以及下一代產品的研發、提升全棧軟件及解決方案能力並在重點行業擴展基於特定場景的AI算力解決方案、進行選擇性投資及收購，以及用於營

運資金及一般企業用途。鑒於截至2026年5月31日，全球發售所得款項中分配予營運資金及一般企業用途的部分已有逾70%被動用，董事會認為，為滿足本公司短期資金需求，必須透過配售籌集額外資金。

假設所有配售股份均獲悉數配售，配售所得款項總額及所得款項淨額(扣除佣金及估計開支後)預期分別為約7,071.9百萬港元及約7,033.5百萬港元。據此計算，每股配售股份的淨發行價將約為473.41港元。

配售所得款項淨額擬將主要用於以下用途：

(i) 所得款項淨額的約60%將用於關鍵材料及零部件的戰略性供應鏈韌性及採購規劃

自2026年初以來，AI算力行業已進入大規模商業化階段，中國AI算力基礎設施需求快速增長。隨著AI應用從模型訓練拓展至大規模推理、企業部署、雲服務、邊緣計算及行業專用解決方案，客戶日益需要穩定的產品交付、可預期的部署安排及可靠的長期支持。與此同時，全球半導體供應鏈仍面臨產能、採購成本、交付周期及地緣政治不確定性等方面的波動，內存產品、晶圓、基板、封裝材料、印刷電路板(PCB)相關部件、服務器部件以及GPGPU加速卡及AI算力系統所需的其他關鍵材料等關鍵部件均受到影響。其中，由於全球供應受限且高度集中，內存產品的價格已經歷前所未有的波動。

隨著GPGPU產品及AI算力解決方案的商業化部署持續擴大，本公司有必要在產品生命周期各環節提升供應鏈可視性及韌性，包括從產品設計、工程驗證到量產、客戶交付及售後支持。本公司擬將配售所得款項用於強化採購能力及供應鏈保障，包括保障關鍵部件供應、加強供應商准入及管理、在適當情況下與供應商訂立戰略採購安排，並且審慎地為現有及下一代產品所需的關鍵材料、模組和零部件建立緩衝庫存。

(ii) 所得款項淨額的約15%將用於加速現有產品的產品迭代及工程驗證，以及加快推進下一代產品的研發及商業化進程

自本公司於2026年初上市以來，由於包括先進封裝、光互連、機架級計算及液冷等的AI算力技術迅速發展變化，AI算力行業的競爭正日益由單純基於單芯片峰值性能的競爭，轉向圍繞真實工作負載下的有效性能、系統級部署能力、軟件兼容性、集群效率、性價比及供應可靠性的綜合競爭。因此持續的產品迭代及前瞻性研發對於本公司保持行業領先地位、維持本公司的競爭力以及支持客戶不斷演進的AI工作負載至關重要。

配售所得款項將用於深度優化本公司的自研指令集架構、計算核心、內存子系統、片上及點對點互聯、軟件棧、系統架構及產品形態。

該等優化工作將支持當前GPGPU產品的持續迭代、工程驗證及商業化。在性能方面，本公司擬透過提升運算密度、內存頻寬、互聯效率及集群可擴展性提高效率，並計劃進一步改善雲端及邊緣部署場景中低精度及混合精度運算、吞吐量、延遲及成本效益。在應用方面，本公司計劃深化在機器人、智能終端、具身智能、工業檢測、智能零售及其他物理世界AI應用中的邊緣運算佈局，重點關注高效率推理、低功耗、即時響應及可靠性。

為積極應對AI訓練及推理對GPU算力解決方案需求的快速演變，本公司已圍繞未來產品建立清晰的架構路線圖。配售所得款項亦將用於支持下一代產品的研發，包括架構設計、性能仿真、邏輯設計、驗證、流片準備、工程樣片測試、產品驗證、軟硬件協同優化及基準測試等工作，亦將用於提升生產準備能力、擴大產能規模及強化供應鏈保障。

(iii) 所得款項淨額的約10%將用於提升全棧軟件平台、模型適配及開發者生態系統，並在重點行業擴展基於特定場景的AI算力解決方案

隨著客戶日益從有效算力、遷移成本、開發體驗及生態兼容性等方面評估AI計算，且AI應用需求正由單一算力採購延伸至模型適配、系統集成及行業場景優化，穩定的全棧軟件平台及場景化解決方案能力已成為GPGPU產品及AI算力解決方案實現商業價值的關鍵。本公司計劃將配售所得款項用於進一步提升自研軟件棧、開發者生態建設、模型適配能力及全棧AI算力解決方案能力，同時加速GPGPU產品及AI算力解決方案在重點行業及新興場景中的部署。

本公司已發佈一個全新一代軟件開發平台，原生兼容行業主流GPU編程模型，並將繼續投入大模型推理加速、預填充與解碼分離、混合專家模型(MoE)訓練優化等技術，以進一步擴大模型庫及開發者生態系統覆蓋範圍。同時在token消耗量快速增長帶動下，本公司將聚焦對國產化、高效及可擴展AI算力基礎設施需求不斷增長的重點行業及應用場景。配售所得款項預計將用於支持參考架構開發、客戶概念驗證項目、基於特定場景的解決方案包、技術支持資源、與客戶及生態夥伴建立聯合實驗室或協作項目，以及面向特定垂直應用的優化工作。

(iv) 所得款項淨額的約10%將用於選擇性戰略投資及收購

為了確保供應鏈韌性、取得差異化的IP並擴展系統級能力，AI算力行業日益呈現垂直整合與生態系統整合的趨勢。本公司認為保留戰略投資及收購的靈活性將有助於加快能力建設、拓展生態佈局、獲取互補技術、深化產業合作，並最終致使本公司有效應對行業變化及把握新興技術趨勢，進一步鞏固其作為全棧GPGPU及AI算力解決方案提供商的地位。

本公司擬將配售所得款項用於進行與其核心業務互補並符合其長期戰略的選擇性戰略投資、收購、合資安排或技術合作。本公司將從包括技術成熟度、IP歸屬、商業化可擴展性、合理估值、客戶渠道或供應鏈中的業務協同效應、監管合規性、財務影響及對本公司生態系統的長期貢獻等關鍵標準評估潛在機會。截至本公告日期，本公司尚未確定任何具體投資或收購目標。

(v) 所得款項淨額的約5%將用於營運資金及一般企業用途

配售所得款項將用於補充日常營運的營運資金，以及其他一般企業用途。

上述配售所得款項淨額用途的摘要載列如下：

所得款項淨額的預期用途	估總所得款項 淨額的概約 百分比	所得款項淨額 的分配 (百萬港元)	預期動用所得款項 淨額的時間表
(i) 關鍵材料及零部件的戰略性供應鏈韌性及採購規劃	60.0%	4,220.1	截至2027年底
(ii) 加速現有產品的產品迭代及工程驗證，以及加快推進下一代產品的研發及商業化進程	15.0%	1,055.0	截至2027年底
(iii) 提升全棧軟件平台、模型適配及開發者生態系統，並在重點行業擴展基於特定場景的AI算力解決方案	10.0%	703.35	截至2027年底
(iv) 選擇性戰略投資及收購	10.0%	703.35	截至2027年底
(v) 營運資金及一般企業用途	5.0%	351.7	截至2027年底
總計	100.0%	7,033.5	

配售協議的條款(包括配售價及配售佣金)乃經本公司與配售代理經公平交易原則進行磋商後釐定。董事(包括獨立非執行董事)認為，配售協議的條款(包括配售價及配售佣金)乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東整體的利益。

董事會認為，配售提供了一個有效且適時的機會，既可籌集資金，亦可使本公司股東基礎更加多元化。配售所得款項淨額將提供必要資金，用以推動尖端技術的研發、加速其下一代GPGPU產品及AI算力解決方案的商業化，並在AI算力價值鏈中進行選擇性戰略投資，從而鞏固本集團的財務狀況，使本集團能夠把握AI算力基礎設施需求快速增長的契機。據此，董事會認為，配售乃按正常商業條款進行，屬公平合理，並符合本公司及股東整體的利益。

儘管於2026年5月31日，全球發售所得款項淨額(詳情見下文)中仍有約2,465.2百萬港元尚未動用，但該等資金將繼續按照招股章程所載的擬定用途使用。鑒於本公司過往的優異表現及持續推行的增長計劃，本公司相信，配售提供了一個機會，可進一步提升本集團的財務實力、市場競爭力及整體能力，並促進本集團的長期健康及可持續發展。

過去十二個月的股本集資活動

於2026年1月8日，H股於聯交所主板上市。扣除包銷費用、佣金及其他發售開支後，全球發售所得款項淨額約為3,509.3百萬港元，已經及將會繼續用於招股章程所載用途。

於2026年5月31日，全球發售所得款項淨額的擬定及實際用途載列如下：

所得款項淨額擬定用途	所得款項淨額分配 (百萬港元)	佔所得款項淨額總額百分比	由上市日期起直至2026年5月31日的已動用金額 (百萬港元)	截至2026年5月31日未動用金額 (百萬港元)	動用未動用所得款項淨額的擬定時間表
(i) 產品及解決方案研發	2,807.4	80.0%	701.5	2,106.0	2028年底前
(ii) 銷售及營銷	350.9	10.0%	83.9	267.0	2028年底前
(iii) 營運資金及一般企業用途	350.9	10.0%	258.7	92.2	2027年底前
合計	<u>3,509.3</u>	<u>100.0%</u>	<u>1,044.1</u>	<u>2,465.2</u>	

附註：本表呈列數字均為約數，可能受貨幣匯率波動及四捨五入影響。

除上文所披露者外，本公司於緊接本公告日期前過去12個月內並無進行任何股本集資活動。

配售對本公司股權架構的影響

下表載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨配售完成後的股權架構(假設配售將悉數完成，且本公司已發行股本總額自本公告日期起直至配售完成止並無其他變動)。

	於本公告日期 ⁽¹⁾		緊隨配售完成後 ⁽⁵⁾	
	股份數目	佔已發行股份 總數概約百分 比 ⁽⁴⁾	股份數目	佔已發行股份 總數概約百分 比 ⁽⁴⁾
非上市股份	9,215,771	3.62%	9,215,771	3.42%
H股	245,101,965	96.38%	259,958,965	96.58%
核心關連人士	106,487,068	41.87%	106,487,068	39.56%
— 持股平台 ⁽²⁾	54,034,125	21.25%	54,034,125	20.07%
— 大鈺資本實體 ⁽³⁾	52,452,943	20.62%	52,452,943	19.49%
承配人	—	—	14,857,000	5.52%
其他公眾H股股東	138,614,897	54.50%	138,614,897	51.50%
合計	254,317,736	100.00%	269,174,736	100.00%

附註：

- (1) 該計算乃基於本公司於本公告日期的已發行股份總數，即254,317,736股，其中包括9,215,771股非上市股份及245,101,965股H股。
- (2) 上海數麒商務諮詢有限公司（「上海數麒」）是各持股平台的普通合夥人，因此根據證券及期貨條例，被視為於該等持股平台持有的合共54,034,125股H股中擁有權益。本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官蓋魯江先生為上海數麒的唯一股東及唯一董事，因此根據證券及期貨條例，被視為於各持股平台所持有的H股中擁有權益。
- (3) 此數額為以下各項的總和：(i)大鈺一期投資基金直接持有的18,269,383股H股；(ii)南京優昀直接持有的16,503,313股H股；(iii) Masterwork Holdings直接持有的11,726,485股H股；以及(iv)廈門鈺美直接持有的5,953,762股H股。
- (4) 百分比已四捨五入至最接近的小數點後兩位，表中所列總額與金額總和之間的任何差異均為四捨五入所致。
- (5) 上述假設是，自本公告日期起至交割日期止，除配發及發行配售股份外，本公司的已發行股本並無變動。

上市申請

本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。

向中國監管機構備案

配售股份獲發行並於聯交所上市後，本公司將根據相關適用法律法規向中國監管機構備案，包括中國證監會備案。

修訂公司章程

配售完成後，本公司的註冊資本及股份總數將分別變更為人民幣269,174,736元及269,174,736股股份。為反映本公司註冊資本及總股本的該等變動，公司章程將作相應修訂(「修訂公司章程」)。

根據中國公司法及公司章程規定及於年度股東會上通過有關一般授權的決議案，董事會將對公司章程作出其認為適當的相應修訂，以反映根據一般授權發行額外股份導致的本公司註冊資本及總股本變動。

由於配售完成須待配售協議項下的若干先決條件達成後方可作實，故配售未必會進行。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「年度股東會」	指	本公司於2026年6月29日舉行的年度股東會
「AI」	指	人工智能
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港商業銀行開門進行一般銀行業務交易的任何日子(星期六或星期日除外)

「大鈺資本實體」	指	福建大鈺一期投資合夥企業(有限合夥)(「 大鈺一期投資基金 」)、南京優昫股權投資合夥企業(有限合夥)(「 南京優昫 」)、Masterwork Holdings Limited(「 Masterwork Holdings 」)及廈門鈺美企業管理合夥企業(有限合夥)(「 廈門鈺美 」)的統稱
「交割」	指	根據配售協議完成配售
「交割日期」	指	2026年7月13日，即配售的交割日期，應為配售協議日期後第二個營業日或本公司與整體協調人(為其本身及代表配售代理)書面協定且符合上市規則的有關其他時間及／或日期
「本公司」	指	上海天數智芯半導體股份有限公司(前稱上海天數智芯半導體有限公司)，一家於2015年12月29日在中國成立的股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「中國證監會備案」	指	就或關於配售分別根據中國證監會備案規則及其他適用法律、法規及中國證監會規定，向中國證監會所作或將所作的所有書面、口頭或任何形式的信函、備案、函件、通訊、文件、回覆、承諾及提交書面資料連同其任何修訂、補充及／或修改(包括但不限於中國證監會備案報告)
「中國證監會備案報告」	指	本公司根據中國證監會備案規則向中國證監會提交有關配售的備案報告(包括其任何修訂、補充及／或修改)

「中國證監會備案規則」	指	中國證監會發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及其配套指引(自2023年3月31日起生效)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	根據股東於年度股東會上通過的決議案授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%的額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)，即不超過50,863,547股新股份
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售(各自的定義見招股章程)
「GPGPU」	指	圖形處理單元通用運算
「GPU」	指	圖形處理單元
「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，於聯交所上市
「H股股權激勵計劃」	指	由股東於年度股東會批准的H股股權激勵計劃
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(定義見上市規則)的任何人士或實體
「IP」	指	知識產權
「最後交易日」	指	2026年7月8日，即配售協議簽訂前的最後交易日

「上市」	指 H股於2026年1月8日在聯交所主板上市
「上市委員會」	指 負責考慮上市申請並批准上市的聯交所上市委員會
「上市日期」	指 2026年1月8日，H股上市及H股首次獲准於聯交所開始交易的日期
「上市規則」	指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「主板」	指 由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「整體協調人」	指 高盛(亞洲)有限責任公司(按字母順序)、摩根士丹利亞洲有限公司(按字母順序)及華泰金融控股(香港)有限公司
「承配人」	指 配售代理根據配售協議促使認購任何配售股份的任何個人、專業、公司、機構及其他投資者
「配售」	指 配售代理或其代表按照配售協議所載的條款及在其條件規限下配售配售股份
「配售代理」	指 高盛(亞洲)有限責任公司(按字母順序)、摩根士丹利亞洲有限公司(按字母順序)、華泰金融控股(香港)有限公司及J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
「配售協議」	指 本公司與配售代理於2026年7月9日(聯交所交易時段前)就根據一般授權進行配售訂立的配售協議
「配售價」	指 每股配售股份476.00港元
「配售股份」	指 根據配售協議的條款及條件將予配發及發行的14,857,000股新H股

「中國」	指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「中國公司法」	指 中國公司法
「招股章程」	指 本公司日期為2025年12月30日的招股章程
「研發」	指 研究與開發
「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指 證券及期貨條例(香港法例第571章)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括非上市股份及H股
「股東」	指 股份持有人
「持股平台」	指 上海溯識商務諮詢合夥企業(有限合夥)、上海溢識企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、上海曦識企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、上海納識商務諮詢合夥企業(有限合夥)、上海悅識企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、上海源識企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)及上海琮羽商務諮詢合夥企業(有限合夥)的統稱
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指 具有上市規則賦予的涵義
「主要股東」	指 具有上市規則賦予的涵義

「庫存股份」	指 具有上市規則賦予的涵義
「美國」	指 美利堅合眾國
「非上市股份」	指 本公司發行的每股面值為人民幣1.00元的非上市普通股，並無於任何證券交易所上市或買賣
「%」	指 百分比

承董事會命
 上海天數智芯半導體股份有限公司
 董事會主席
 蓋魯江先生

香港，2026年7月9日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蓋魯江先生、孫怡樂先生、劉崢先生及楊磊先生；非執行董事王晨先生及丁俊博先生；及獨立非執行董事滕勇博士、任今濤先生及王燕博士。